

HDI PCB Technics Capacity

No.	アイテム	説明	データシート
1	基板材料	ブランド	SY、ITEQ、KB、NOUYA
2	HDI 構成		1+N+1、2+N+2、3+N+3、4+N+4、5+N+5、6+N+6、任意的相互接続
3	工事発注		N+N、N+X+N、1+(N+X+N)+1
4	階層		1-40Layers
5	最小パターン幅/間隔	Unit:mil	2/2
6	最小機械穴	Unit:mm	0.15mm
7	コアボードの最小厚さ	Unit:mil	2mil
8	レーザーホール	Unit:mm	0.075mm-0.1mm
9	PP最小厚さ	Unit:mil	2mil
10	樹脂プラグ穴の最大径	Unit:mm	0.4mm
11	電解フィル・ホール		可
12	電解フィル・ホールサイズ	Unit:mil	3-5mil
13	穴パイルパッド/穴パイルホール/パッドホール (VOP)	mil	可
14	ビアホールの壁からパターンまでの距離	mil	7mil
15	レーザー穴あけ精度	mil	0.025mm

HDI PCB Technics Capacity

16	最小BGAパッド中心距離	mil	0.3mm
17	最小SMT	mil	0.25mm
18	めっき穴埋めサグ	mil	≤10um
19	裏穴明け/カウンターシンクホール公差	mil	±0.05mm
20	スルーホールめっき貫通能力	Rate	16:1
21	ブラインドホールめっき貫通容量	Rate	1.2:1
22	BGA最小PAD	Unit:mil	0.2
23	最小穴埋め(マシン穴)	Unit:mil	0.2
24	最小穴埋め(レーザー穴)	Unit:mil	0.1
25	最小ブラインドホール(レーザー穴)	Unit:mil	0.1
26	最小ブラインドホール(マシン穴)	Unit:mil	0.2
27	レーザー穴とマシン穴の最小間隔	Unit:mil	0.2
28	最小レーザー穴	Unit:mil	0.10(depth≤55um)、0.13(depth≤100um)
29	最小BGAパッド中心距離	Unit:mil	0.3
30	層間アライメント	Unit:mil	±0.05mm(±0.002")
			ビアホール壁からパターンまでの距離